

2024年第三代半导体展览会-电子芯片展

产品名称	2024年第三代半导体展览会-电子芯片展
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会吸引了来自全球各地的参展商、观众和。此次展览会为期三天，展出了新的半导体技术、应用和产品，包括芯片制造、封装测试、材料与设备等领域。同时，还举办了多场高峰论坛和技术研讨会，探讨了半导体产业的发展趋势、技术创新和市场应用。

在展览会上，各大参展商纷纷展示了新的技术和产品。其中，中芯国际展示了其新的14纳米工艺技术，并表示已经实现了量产；华为海思则推出了一款高性能的AI芯片，并应用于其智能手机和平板电脑中；长鑫存储则展示了其新的存储芯片，容量高达1TB。此外，还有许多半导体企业如台积电、联电、格芯等也参加了此次展览会，并展示了各自的技术和产品。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封装、MEMS封装、硅晶圆及IC封装基板、封装基板与应用制造与封装、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材) Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等

4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等

5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等

6、第三代半导体：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等

7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、储存器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等

8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等

9：电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等

10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等汽车雷达传感器上下游供应链各环节产品等

11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等

12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等

13、汽车半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级SiC模块、电源管理芯片、汽车电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、设备商、封测、制造、代工厂商等

除了技术和产品展示外，展览会还举办了多场高峰论坛和技术研讨会。在高峰论坛上，来自全球各地的专家和学者就半导体产业的发展趋势、技术创新和市场应用等议题进行了深入探讨。他们认为，未来半导体产业将继续保持快速发展，同时面临着技术、市场和政策等多方面的挑战。因此，需要加强国际合作与交流，共同推动半导体产业的健康发展。

在展览会期间，还举办了多场技术研讨会。参展商和技术专家们就各种技术和应用进行了深入探讨，如智能传感器、MEMS技术、功率电子等。他们分享了各自的经验和技术成果，为参展商和观众提供了有益的参考和启示。